



科技制造行业：“小而精” 备受关注



摘要：科技制造业一周投融资事件速览

安建半导体获 1.8 亿元 B 轮融资，深耕半导体功率器件。由超越摩尔投资领投，弘鼎资本、龙鼎投资、联和资本、君盛投资和金建诚投资跟投。安建半导体成立于 2016 年，专注于半导体功率器件的研发、设计和销售，赋能高端芯片国产化，产品包括高、低压 MOS 管和 IGBT 功率器件，广泛应用于电力系统、电车、储能、光伏、高压电等。公司的产品线已经涵盖大部分 MOS 管和 IGBT 产品，已有三条产品线实现量产，分别是低电压的 SGT-MOS 管、高电压的 SJ-MOS 管、FieldStopTrenchIGBT，产品均具有高性能高可靠性。本轮融资用于高、低压 MOS 和 IGBT 全系列产品开发、第三代半导体 SiC 器件开发和 IGBT 模块封测厂建设。

路远智能完成超过 1 亿元的 B 轮融资，致力于国产贴片机研发。由达晨领投，招商证券、英飞尼迪资本、加法创投、华强聚丰跟投。路远智能成立于 2016 年，依靠自主研发磁悬浮高速贴片机，成功突破多项核心技术，实现了高端贴片机的国产化，成为全世界仅有的几家贴片机生产制造商之一。贴片机是电子制造过程中的关键核心设备，公司的贴片机拥有整机自动校正、料带自动剪切装置、线性扫描识别系统等核心技术，广泛应用于通信、半导体，泛半导体、智慧城市、智能家居、人工智能等领域。过去贴片机几乎全部依靠进口，现在公司的客户包括美的、TCL、LG 等龙头企业。

爱普特完成超亿元 A 轮融资，加速国产 MCU 的产业布局。由亚商资

本、临芯资本、投控东海、深圳担保集团、深圳市人才基金、国创资本等投资。爱普特成立于 2012 年，是专注于高性能 32 位嵌入式处理器(MCU)、IOTSoC 的设计与研发生产的企业。公司产品贴合市场需求，已广泛应用于大小家电、消费电子、智能硬件、安防工控、医疗电子、智能家居、汽车电子、物联网等领域。依靠集成度高、产品系列齐全、领先技术集成、可靠性高、易于开发等优势得到了客户的广泛认同，客户包括美的、小米、飞利浦、松下电器、惠而浦等龙头企业。本轮融资的资金将主要用于多个平台的国产 32 位 MCU 的研发设计、产品的产业化，引领智能产品创新应用升级，打造全国产嵌入式处理器生态圈。

赛尔特电子完成阳光电源领投的 A 轮融资。赛尔特电子成立于 2000 年，是一家专注于电路控制及安全保护元器件电阻生产、研发的企业。产品包括压敏电阻(MOV)、热保护型压敏电阻、电涌保护器、瞬态电压抑制二极管(TVS)、气体放电管(GDT)，广泛应用于电源、新能源、家电、移动设备等领域。

容微精密完成数千万元 A 轮融资，布局半导体测试耗材领域。由华强创投领投。容微精密成立于 2012 年，主要为集成电路产品提供可靠性验证，产品包括系统级封装测试插座、高频测试插座、大功率器件测试插座、晶圆级测试插座等，属于半导体测试环节的核心耗材，主要应用领域在晶圆生产后的 CP 测试及 FT 测试环节。公司的半导体测试底座 Socket 及探针卡产品属于半导体测试环节的核心耗材，可靠性、一致性非常高。

关键词: 人工智能 光伏 创投 安防 新能源 智慧城市 智能家居 智能硬件 物联网 芯片

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_40321

